

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一五年六月三十日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一五年第二季的銷售額為創新高的伍億肆仟陸佰陸拾萬美元，較二零一五年第一季的伍億零玖佰捌拾萬美元季度增加 7.2%，較二零一四年第二季的伍億壹仟壹佰參拾萬美元年度增加 6.9%。
- 二零一五年第二季的毛利為創新高的壹億柒仟陸佰肆拾萬美元，較二零一五年第一季的壹億肆仟玖佰玖拾萬美元季度增加 17.7%，較二零一四年第二季壹億肆仟參佰壹拾萬美元年度增加 23.3%
- 二零一五年第二季毛利率為創新高的 32.3%，相比二零一五年第一季為 29.4%，及二零一四年第二季為 28.0%。
- 二零一五年第二季中芯國際應佔利潤為柒仟陸佰柒拾萬美元，相比二零一五年第一季為伍仟伍佰伍拾萬美元及二零一四年第二季為伍仟陸佰捌拾萬美元。不包含二零一零年第二季來自股權及認購權授予協定的收益，二零一五年第二季中芯國際應佔利潤為歷史新高。
- 二零一五年第二季中國區銷售額貢獻了總銷售額的 51.1%，是本集團的歷史新高。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零一五年八月十一日就截至二零一五年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本合併財務資訊係依國際財務報告準則編製。

中國上海 — 2015年8月11日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至二零一五年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一五年第三季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。本公司預期：

- 季度收入增加 1%至 3%。
- 毛利率介於 28%至 30%的範圍內。
- 非公認準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，將介於 1 億 3 仟 4 佰萬美元至 1 億 3 仟 9 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 1 仟 1 佰萬美元至正 1 仟 3 佰萬美元之間(非控制權益承擔的損失)。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“中芯在 2015 年連續兩季成長，第三季指引將繼續成長。雖然有些客戶正在經歷庫存調整，中芯成功量產新產品從而保持我們的高產能利用率。

2015 年第二季是中芯有史以來的最好的一個季度，銷售額為伍億肆仟陸佰陸拾萬美元，毛利率為 32.3%，均破歷史紀錄。在第二季度晶圓付運量和產能利用率超過預期，銷售額環比增長 7.2%。第二季中芯國際應佔利潤為柒仟陸佰柒拾萬美元，環比增長 38.3%，同比增長 35.0%。

過去幾個季度以來，中國區的銷售收入份額持續增長，在第二季中國區銷售收入首次超過總銷售收入的一半。中芯作為中國最大的最先進的代工廠，必將牢牢把握中國市場機遇。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一五年八月十二日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

中國 +86 400-620-8038 (密碼：SMIC)

香港 +852 3018-6771 (密碼：SMIC)

臺灣 +886 2-2650-7825 (密碼：SMIC)

美國 +1 845-675-0437 (密碼：SMIC)

二零一五年第二季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

<http://edge.media-server.com/m/p/ijmh7wth>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司(“中芯國際”，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，是世界領先的積體電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的積體電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 28 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠；在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠，一座控股的 300mm 先進制程晶圓廠正在開發中；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com。

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一五年第三季指引”、“資本開支概要”和包含在首席執行官引言裡的敘述，關於我們對成長的預期以及在中國的機遇，乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與

這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括半導體行業的景氣循環、對我們產品的需求改變、市場競爭、對少數客戶的依賴、未決訴訟的頒令或判決、半導體行業高強度的智識產權訴訟，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一五年四月二十八日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會 (包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

關於非一般公認會計準則(“非公認準則”)的財務計量

為補充中芯國際遵照國際財務報告準則表達的合併財務結果，中芯國際在此份新聞稿裡使用了非公認準則的營運開支(其調整為不含雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響數的全部營運開支)，亦包含二零一五年第三季財務指引裡的非公認準則的營運開支。非公認準則的財務計量表達，並不意味著可以僅考慮非公認準則的財務計量，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編製及表達的財務資訊。

中芯國際相信使用這些非公認準則的財務計量，有助於投資者及管理層比較中芯國際過去的業績，本集團管理層規律地使用這些非公認準則財務計量去了解、管理和評估本集團的業務以及去制定財務和營運方面的決策。

後附的表格在每項非公認準則的財務計量及直接可比的公認準則財務計量之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非公認準則計量及公認準則計量之間的調節，在未來的基礎上並不可行。

二零一五年第二季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	二零一四年 季度比較	二零一四年 第二季度	二零一四年 年度比較
收入	546,615	509,798	7.2%	511,344	6.9%
銷售成本	(370,210)	(359,871)	2.9%	(368,291)	0.5%
毛利	176,405	149,927	17.7%	143,053	23.3%
經營開支	(115,728)	(104,423)	10.8%	(84,861)	36.4%
經營利潤	60,677	45,504	33.3%	58,192	4.3%
其他收入(開支)，淨額	11,943	6,125	95.0%	(1,105)	-
除稅前利潤	72,620	51,629	40.7%	57,087	27.2%
所得稅開支	(924)	(54)	1611.1%	93	-
本期利潤	71,696	51,575	39.0%	57,180	25.4%
其他綜合收入					
外幣報表折算差異變動	397	(400)	-	(858)	-
備供出售金融資產價值變動	(1,006)	1,451	-	-	-
本期綜合收入總額	71,087	52,626	35.1%	56,322	26.2%
本期以下各方應佔利潤:					
中芯國際	76,704	55,477	38.3%	56,801	35.0%
非控制權益	(5,008)	(3,902)	28.3%	379	-
本期利潤	71,696	51,575	39.0%	57,180	25.4%
毛利率	32.3%	29.4%	-	28.0%	-
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	0.00	0.00		0.00	
攤薄	0.00	0.00		0.00	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	0.10	0.08		0.09	
攤薄	0.10	0.07		0.08	
付運晶圓(約當 8 吋)	731,730	692,131	5.7%	648,764	12.8%
產能利用率 ⁽³⁾	102.1%	99.7%	-	94.6%	-

附注：

- (1) 基於二零一五年第二季加權平均普通股 371 億 9 千 200 萬股(基本)及 415 億 7 千 200 萬股(攤薄)，二零一五年第一季 358 億 7 千 700 萬股(基本)及 401 億 8 千 100 萬股(攤薄)，二零一四年第二季 327 億 6 千 600 萬股(基本)及 352 億 9 千 100 萬股(攤薄)。
- (2) 每股美國預托股股份代表 50 股普通股股份
- (3) 產能利用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一五年第二季銷售額由二零一五年第一季的 5 億零 9 佰 80 萬元季度增加 7.2%至 5

億 4 仟 6 佰 60 萬元，主要因為二零一五年第二季晶圓付運量增加所致。

- 二零一五年第二季的銷售成本由二零一五年第一季的 3 億 5 仟 9 佰 90 萬元季度上升 2.9%至 3 億 7 仟零 20 萬元。
- 二零一五年第二季的毛利由二零一五年第一季的 1 億 4 仟 9 佰 90 萬元季度增加 17.7%至 1 億 7 仟 6 佰 40 萬元。
- 二零一五年第二季的毛利率由二零一五年第一季的 29.4%上升至 32.3%，主要由於二零一五年第二季產能利用率增加所致。
- 二零一五年第二季的經營開支由二零一五年第一季的 1 億零 4 佰 40 萬元季度增加 10.8%至 1 億 1 仟 5 佰 70 萬元，主要原因請詳下文經營開支（收入）分析。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	二零一四年 第二季度
電腦	4.5%	3.6%	2.8%
通訊	49.4%	44.2%	41.4%
消費	37.7%	46.3%	48.0%
其他	8.4%	5.9%	7.8%
以服務分類	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	二零一四年 第二季度
晶圓	95.4%	96.3%	95.4%
光罩製造，晶圓測試及其它	4.6%	3.7%	4.6%
以客戶類別分類	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	二零一四年 第二季度
無廠房半導體公司	72.7%	81.3%	85.2%
集成裝置製造商	2.7%	2.5%	3.0%
系統公司及其它	24.6%	16.2%	11.8%
以地區分類	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	二零一四年 第二季度
北美洲	32.0%	41.1%	42.0%
中國 ⁽¹⁾	51.1%	47.0%	44.4%
歐亞 ⁽²⁾	16.9%	11.9%	13.6%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	二零一四年 第二季度
40/45 納米	15.3%	16.0%	13.2%
55/65 納米	25.2%	26.1%	26.3%
90 納米	4.8%	4.6%	3.4%
0.13 微米	10.9%	10.2%	12.1%
0.15/0.18 微米	39.9%	39.7%	40.2%
0.25/0.35 微米	3.9%	3.4%	4.8%

附註：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國及香港

產能*

晶圓廠/(晶圓尺寸)	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度
上海廠(8吋)	99,000	97,000
上海 12吋廠 (12吋)	31,500	31,500
北京廠(12吋)	83,250	81,000
天津廠(8吋)	42,000	42,000
晶圓代工生產月產能合計**	255,750	251,500

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

**截止 2015 年第二季底，我們在深圳的新 8 吋晶圓廠及北京的新 12 吋晶圓廠已達到 10,000 片及 600 片的裝機產能，但尚未進入大量生產。

- 月產能由二零一五年第一季的 25 萬 1 仟 500 片 8 吋晶圓增加至二零一五年第二季的 25 萬 5 仟 750 片 8 吋晶圓，主要由於我們的上海 8 吋晶圓廠和北京 12 吋晶圓廠產能利用率增加所致。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	二零一四年 季度比較	二零一四年 第二季度	年度比較
付運晶圓	731,730	692,131	5.7%	648,764	12.8%
產能利用率 ⁽¹⁾	102.1%	99.7%	-	94.6%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	季度比較	二零一四年 第二季度	年度比較
銷售成本	370,210	359,871	2.9%	368,291	0.5%
折舊	95,942	100,929	-4.9%	106,236	-9.7%
其他製造成本	272,552	257,708	5.8%	260,365	4.7%
股權報酬	1,716	1,234	39.1%	1,690	1.5%
毛利	176,405	149,927	17.7%	143,053	23.3%
毛利率	32.3%	29.4%	-	28.0%	-

- 二零一五年第二季的銷售成本由二零一五年第一季的 3 億 5 仟 9 佰 90 萬元季度上升 2.9% 至 3 億 7 仟零 20 萬元。
- 二零一五年第二季銷售成本中的折舊減少 4.9% 至 9 仟 5 佰 90 萬元，相比二零一五年第一季為 1 億零 90 萬元。該減少主要因為二零一五年第二季我們的 12 吋晶圓廠產能利用率增加所致。
- 二零一五年第二季銷售成本中的其他製造成本增加 5.8% 至 2 億 7 仟 2 佰 60 萬元，相比二零一五年第一季為 2 億 5 仟 7 佰 70 萬元。
- 二零一五年第二季的毛利由二零一五年第一季的 1 億 4 仟 9 佰 90 萬元季度增加 17.7% 至 1 億 7 仟 6 佰 40 萬元。
- 二零一五年第二季的毛利率由二零一五年第一季的 29.4% 上升至 32.3%，主要由於二零一五年第二季產能利用率增加所致。

經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	季度比較	二零一四年 第二季度	年度比較
經營開支	115,728	104,423	10.8%	84,861	36.4%
研究及開發開支，淨額	55,202	53,453	3.3%	45,080	22.5%
一般及行政開支	52,051	42,486	22.5%	35,528	46.5%
銷售及市場推廣開支	9,159	9,205	-0.5%	9,018	1.6%
其他經營收入	(684)	(721)	-5.1%	(4,765)	-85.6%

- 二零一五年第二季的研究及開發開支增加為 5 仟 5 佰 20 萬元，相比二零一五年第一季為 5 仟 3 佰 50 萬元。不包含研究發展合約上獲得政府支持的資金，則研究及開發開支為季度增加 6 百 80 萬元至二零一五年第二季的 6 仟 5 佰 60 萬元。研究發展合約上獲得政府支持的資金在二零一五年第二季為 1 仟零 40 萬元，相比二零一五年第一季為 5 佰 30 萬元。
- 二零一五年第二季的一般及行政開支由二零一五年第一季的 4 仟 2 佰 50 萬元季度上升 22.5% 至 5 仟 2 佰 10 萬元，主要因為二零一五年第二季 1) 關於兩個新晶圓廠計畫-深圳 8 吋晶圓廠和北京 12 吋晶圓廠的擴廠費用及 2) 計提員工花紅增加所致。

其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	季度比較	二零一四年 第二季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	11,943	6,125	95.0%	(1,105)	-
利息收入	956	1,369	-30.2%	3,021	-68.4%
財務費用	(2,416)	(5,010)	-51.8%	(8,231)	-70.6%
外幣匯兌收益或虧損	4,960	120	4033.3%	(1,860)	-
其他收益或虧損，淨額	8,592	9,621	-10.7%	5,399	59.1%
應佔聯營公司利潤	(149)	25	-	566	-

- 財務費用的變動主要由於 1)本集團在二零一五年第一季清償部分銀行貸款及 2)二零一五年第二季有較多的財務費用撥充資本為部分的在建資產所致。
- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於二零一五年第二季人民幣較美元升值所致。外幣資產主要包含人民幣計價的現金及現金等價物和應收款。外幣負債主要包含人民幣計價的貸款、應付款和其他應付款。本集團為淨外幣資產頭寸。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度	季度比較	二零一四年 第二季度	年度比較
折舊及攤銷	124,911	125,461	-0.4%	138,463	-9.8%

流動資金

以千美元計	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度
現金及現金等價物	766,165	402,378
限制性現金	105,791	229,500
其他財務資產 ⁽¹⁾	568,886	586,047
貿易及其他應收賬款	489,675	454,383
預付款項及預付經營開支	37,507	38,969
存貨	365,332	340,889
流動資產總計	2,333,356	2,052,166
流動稅項負債	412	33
預提負債	132,714	124,711
遞延政府資金	62,368	65,200
短期借款	119,727	192,775
貿易及其他應付款項	863,210	699,467
流動負債總計	1,178,431	1,082,186
現金比率 ⁽²⁾	0.7x	0.4x
速動比率 ⁽³⁾	1.7x	1.6x
流動比率 ⁽⁴⁾	2.0x	1.9x

附注：

- (1) 其他財務資產包含銀行出售的財務產品及超過三個月的銀行定存。
- (2) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。
- (3) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
- (4) 流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。

資本結構

以千美元計	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度
現金及現金等價物	766,165	402,378
限制性現金	105,791	229,500
其他財務資產 ⁽¹⁾	568,886	586,047
短期借款	119,727	192,775
長期借款	85,484	39,087
可換股公司債	385,947	382,668
應付債券	492,383	491,976
債務總計	1,083,541	1,106,506
淨債務 ⁽²⁾	(251,510)	118,081
權益	3,846,024	3,364,264
總債務對股本比率 ⁽³⁾	28.2%	32.9%
淨債務對股本比率 ⁽⁴⁾	N/A ⁽⁵⁾	3.5%

附注：

- (1) 其他財務資產包含銀行出售的財務產品及超過三個月的銀行定存。
- (2) 淨債務系債務總計減現金及現金等價物以及其他財務資產。
- (3) 債務總計除以權益。
- (4) 淨債務除以權益。
- (5) 由於二零一五年第二季的淨債務為負值，因此該比率不適用。

現金及現金等價物由二零一五年第一季的 4 億零 2 佰 40 萬元增加至二零一五年第二季的 7 億 6 仟 6 佰 20 萬元，主要因為完成對中國集成電路產業投資基金有限公司的 47 億股普通股私募所致。

現金流量概要

以千美元計	二零一五年 第二季度	二零一五年 第一季度
經營活動所得現金淨額	154,577	134,273
投資活動所用現金淨額	(170,372)	(148,888)
融資活動所得(所用)現金淨額	379,423	(185,819)
滙率變動的影響	159	(224)
現金變動淨額	363,787	(200,658)

資本開支概要

- 二零一五年第二季資本開支為 3 億 6 仟 7 佰 60 萬元。
- 二零一五年計劃用於晶圓廠運作的資本開支約為 15 億元。
- 二零一五年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支約為 1.5 億元，主要用於雇員生活園區的建造。本集團計畫日後將該住宿單位出租或售於雇員。

近期公佈

- 董事名單與其角色和職能 (2015-06-26)
- 二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果 (2015-06-26)
- 中芯國際榮獲 Qualcomm “2014 年度代工供應商獎” (2015-06-25)
- 中芯國際與華為、imec、Qualcomm 共同投資中芯國際集成電路新技術研發公司 (2015-06-23)
- 獨立非執行董事退任及撤回日期為二零一五年四月三十日之股東週年大會通告第 2(d)項決議案 (2015-06-23)
- 不獲豁免關連交易大唐及 COUNTRY HILL 之優先認購事項 及授予一名董事受限制股份單位 (2015-06-12)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2015-06-08)
- 根據一般授權完成發行 4,700,000,000 股新股份予國家集成電路產業投資基金股份有限公司之全資附屬公司 (2015-06-08)
- 燦芯半導體協同 CEVA 及中芯國際共同開發物聯網 ASIC 平台 (2015-06-02)
- 中芯國際攜手業界為“芯肝寶貝計劃”再捐 276.82 萬元 (2015-06-01)
- 授出購股期權 (2015-05-21)
- 中芯北京 12 英寸新廠房榮獲 LEED 認證金獎 (2015-05-15)
- 中芯國際截至二零一五年三月三十一日止三個月未經審核業績公佈 (2015-05-07)
- 通函 - 致新登記股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 (2015-04-29)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2015-04-29)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2015-04-29)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2015-04-29)
- 股東週年大會通告 (2015-04-29)
- 委任代表表格 - 於二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格 (2015-04-29)
- 建議重選董事、授出發行及購回股份之一般授權及股東週年大會通告 (2015-04-29)
- 2014 年年報 (2015-04-29)
- 海外監管公告 (2015-04-29)
- 董事會會議日期通知 (2015-04-20)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併損益及其他綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一五年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (未經審核)
收入	546,615	509,798
銷售成本	(370,210)	(359,871)
毛利	176,405	149,927
研究及開發開支，淨額	(55,202)	(53,453)
一般及行政開支	(52,051)	(42,486)
銷售及市場推廣開支	(9,159)	(9,205)
其他經營收入	684	721
經營開支	(115,728)	(104,423)
經營利潤	60,677	45,504
其他收入，淨額	11,943	6,125
除稅前利潤	72,620	51,629
所得稅費用	(924)	(54)
本期利潤	71,696	51,575
其他綜合收入		
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>		
外幣報表折算差異變動	397	(400)
備供出售金融資產價值變動	(1,006)	1,451
本期綜合收入總額	71,087	52,626
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	76,704	55,477
非控制權益	(5,008)	(3,902)
	71,696	51,575
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	76,090	56,528
非控制權益	(5,003)	(3,902)
	71,087	52,626
中芯國際應佔每股股份盈利		
基本	0.00	0.00
攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利		
基本	0.10	0.08
攤薄	0.10	0.07
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	37,191,800,114	35,876,740,022
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	41,571,630,732	40,180,857,955

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
簡明合併損益及其他綜合收入表(續)
(以千美元為單位，每股資料除外)

截至以下日期止三個月	
二零一五年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (未經審核)

比較公認準則計量而調節出非公認準則的財務計量⁽¹⁾

非公認準則的營運開支	(110,901)	(99,669)
------------	-----------	----------

附註:

- (1) 非公認準則營運開支定義為不包含雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響的營運開支。中芯國際一併覆核了營運開支和非公認準則的營運開支，以了解、管理和評估其業務，以及制定營運和財務方面的決策。本集團也相信這些補充資訊對投資者及分析人員用以評估公司的營運表現來說是有用的。然而，把非公認準則的財務計量當作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非公認準則的財務計量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非公認準則的財務計量不會被其他公司用相同的方法計算，相對於其他公司在使用類似名稱的計量上，或許無法比較。根據上述提到的限制，對於遵照國際財務報告準則編製的營運開支，不應該僅考慮非公認準則的營運開支，或認為非公認準則的營運開支是可選擇的。

下表列示在有關期間由遵照國際財務報告準則編製的營運開支(此為最直接可比較的財務計量)，調節至非公認準則的營運開支。

	截至以下日期止三個月		
	二零一五年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 (未經審核)
營運開支	(115,728)	(104,423)	(84,861)
雇員花紅計提數	16,035	10,492	10,849
政府支持的資金	(11,208)	(5,514)	(8,494)
出售生活園區資產收益	-	(224)	(4,094)
非公認準則的營運開支	(110,901)	(99,669)	(86,600)

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一五年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	3,252,963	3,017,149
預付土地使用權	143,220	134,655
無形資產	202,488	206,562
於聯營公司的投資	160,744	57,520
於合資公司的投資	14,594	-
遞延稅項資產	44,701	44,529
其他資產	12,957	28,582
非流動總資產	3,831,667	3,488,997
<i>流動資產</i>		
存貨	365,332	340,889
預付款項及預付經營開支	37,507	38,969
貿易及其他應收款項	489,675	454,383
其他財務資產	568,886	586,047
受限制現金	105,791	229,500
現金及現金等價物	766,165	402,378
流動總資產	2,333,356	2,052,166
總資產	6,165,023	5,541,163
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一五年六月三十日及二零一五年三月三十一日已發行及 流通股份分別為 40,750,102,963 股及 35,929,902,252 股。	16,300	14,372
股份溢價	4,792,011	4,383,103
儲備	96,168	96,783
累計虧絀	(1,408,709)	(1,485,413)
本公司擁有人應佔權益	3,495,770	3,008,845
非控制權益	350,254	355,419
總權益	3,846,024	3,364,264

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併財務狀況表(續)

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一五年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	85,484	39,087
可換股公司債	385,947	382,668
應付債券	492,383	491,976
遞延稅項負債	1,383	69
遞延政府資金	173,291	178,833
其他負債	2,080	2,080
非流動總負債	<u>1,140,568</u>	<u>1,094,713</u>
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	863,210	699,467
借貸	119,727	192,775
遞延政府資金	62,368	65,200
預提負債	132,714	124,711
流動稅項負債	412	33
流動總負債	<u>1,178,431</u>	<u>1,082,186</u>
總負債	<u>2,318,999</u>	<u>2,176,899</u>
權益及負債合計	<u>6,165,023</u>	<u>5,541,163</u>

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一五年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	71,696	51,575
折舊及攤銷	124,911	125,461
應佔聯營公司利潤	149	(25)
營運資金的變動及其它	(42,179)	(42,738)
經營活動所得現金淨額	154,577	134,273
投資活動:		
對物業、廠房及設備的付款	(235,515)	(224,436)
對無形資產的付款	(6,633)	(9,935)
對土地使用權的付款	(9,265)	-
出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項	41,656	11,486
與投資活動有關的受限制現金變動	122,557	7,770
收購財務資產付款	(551,419)	(657,899)
出售財務資產所得款項	575,380	723,215
處分備供出售投資所得款項	-	1,204
取消附屬公司合併入帳現金流出淨額	(248)	-
取得長期投資付款	(106,885)	(293)
投資活動所用現金淨額	(170,372)	(148,888)
融資活動:		
借款所得款項	79,256	57,626
償還借款	(105,907)	(244,020)
發行普通股所得款項	399,460	-
行使雇員認股權所得款項	6,614	575
融資活動所得(所用)現金淨額	379,423	(185,819)
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	159	(224)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	363,787	(200,658)
現金及現金等價物－期間開始	402,378	603,036
現金及現金等價物－期間結束	766,165	402,378

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

邱慈雲 (首席執行官)

高永崗 (首席財務官)

非執行董事

陳山枝 (替任董事李永華)

周杰

任凱

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

陳立武

周一華

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

邱慈雲

首席執行官兼執行董事

中國北京

二零一五年八月十一日

* 僅供識別